

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
384-1**

1982

AMENDEMENT 3
AMENDMENT 3

1989-04

Amendement 3

**Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques**

**Première partie:
Spécification générique**

Amendment 3

**Fixed capacitors for use in electronic
equipment**

**Part 1:
Generic specification**

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

J

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
40(BC)629 40(BC)631	40(BC)665 40(BC)667	40(BC)679	40(BC)687

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Page 2

- Ajouter à la Section Quatre, les paragraphes suivants:

- 4.33 Montage (pour les condensateurs chipse uniquement)..... 60
- 4.34 Adhérence..... 60
- 4.35 Robustesse des extrémités métallisées..... 60

Page 16

- Ajouter un nouveau paragraphe 2.2.39:

2.2.39 Condensateur chipse

Condensateur fixe dont les petites dimensions et la nature ou la forme des sorties rendent approprié son montage dans les circuits hybrides et en surface des cartes imprimées.

Page 18

Paragraphe 3.1

Remplacer le texte existant par:

3.1.1 Quand ces documents sont utilisés dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité complet tel que le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ), avec homologation et contrôle de la conformité de la qualité, on doit suivre les procédures des paragraphes 3.4 et 3.5.

3.1.2 Quand ces documents sont utilisés à l'extérieur d'un système d'assurance de la qualité tel que le Système IECQ à des fins telles que l'épreuve d'une conception ou des essais de type, les procédures et les exigences des paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 b) peuvent être appliquées, mais, en tous les cas, les essais et parties d'essai doivent être effectués dans l'ordre donné dans le programme d'essais.

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
40(CO)629 40(CO)631	40(CO)665 40(CO)667	40(CO)679	40(CO)687

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Page 3

- Add in Section Four, the following sub-clauses:

4.33 Mounting (for chip capacitors only).....	61
4.34 Adhesion.....	61
4.35 Bond strength of the end face plating.....	61

Page 17

- Add a new Sub-clause 2.2.39:

2.2.39 Chip capacitor

A fixed capacitor whose small dimensions and nature or shape of terminations make it suitable for use in hybrid circuits and on printed boards.

Page 19**Sub-clause 3.1**

Replace the existing text by:

- 3.1.1 When these documents are being used for the purposes of a full quality assessment system such as the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ), with Qualification Approval and Quality Conformance Inspection, the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall be complied with.
- 3.1.2 When these documents are used outside such quality assessment systems as the IECQ system for purposes such as design proving or type testing, the procedures and requirements of Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2 b) may be used, but the tests and parts of tests shall be applied in the order given in the test schedules.

Page 40Paragraphe 4.14.2

Remplacer le texte existant par:

4.14.2 Sauf prescrit par la spécification applicable, les condensateurs doivent être soumis à l'un des essais suivants comme prescrit par la spécification applicable:

- a) Tous les condensateurs à l'exception de ceux des articles b) et c) ci-après:

Méthode 1A de l'essai Tb de la Publication 68-2-20 (1979) de la CEI, avec une durée de 5 s ou 10 s, comme spécifié dans la spécification particulière.

Profondeur d'immersion à partir du plan d'appui: $2^{+0}_{-0,5}$ mm en utilisant un écran isolant du point de vue thermique de $1,5 \pm 0,5$ mm d'épaisseur.

- b) Condensateurs décrits dans la spécification particulière comme non conçus pour l'utilisation sur cartes imprimées:

Méthode 1B de l'essai Tb de la Publication 68-2-20 (1979) de la CEI.

Profondeur d'immersion à partir du corps du composant $3,5^{+0}_{-0,5}$ mm.

- c) Pour les condensateurs chipse, une des méthodes du bain d'alliage suivantes doit être appliquée comme prescrit dans la spécification particulière:

Méthode 1

Le condensateur chipse doit être tenu par une petite pince en acier inoxydable comme indiqué en figure 1. Aucune partie de la pince ne doit être en contact avec les extrémités métallisées du condensateur.

Le condensateur chipse, tenu comme décrit ci-dessus, doit être immergé dans un flux non activé comportant 0,2% de chlorure pendant 2 s environ. Ensuite on doit laisser s'égoutter l'excès de flux.

Le condensateur chipse doit alors être immergé dans le bain d'alliage, jusqu'à une profondeur de 10 mm. La température du bain doit être de 260 ± 5 °C. Le temps d'immersion de $5 \pm 0,5$ s ou 10 ± 1 s comme prescrit dans la spécification particulière.

Après un temps inférieur à 60 min les résidus de flux doivent être enlevés du condensateur en le nettoyant à l'aide d'un solvant approprié (voir Publication 68-2-45 de la CEI, paragraphe 3.1.1).

Méthode 2

Le condensateur chipse doit être tenu par un outil approprié par la partie non métallisée de son corps.

Les sorties doivent être successivement immergées de telle façon que les surfaces métallisées soient entièrement couvertes par le bain d'alliage.